

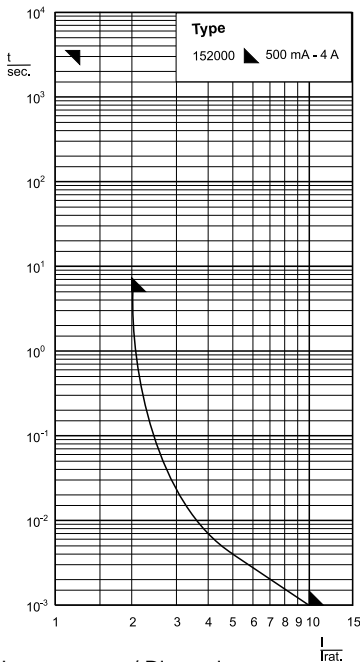


**Kleinstsicherungen
SMD**

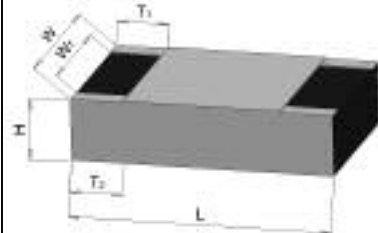
**Sub-miniature fuse-links
SMD**

**Fusibles subminiatures
SMD**

**Strom-Zeit-Kennlinien
Current Time Characteristics
Caractéristique courant/temps**

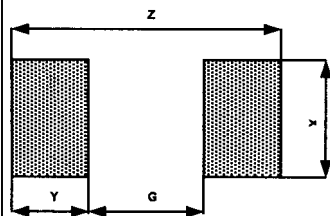


Abmessungen / Dimensions



- H 0,45 +0,1/-0,05 mm
- L 1,55 ±0,05 mm
- W 0,85 ±0,1 mm
- W_T > 75 % of W
- T₁ 0,3 +0,15/-0,2 mm
- T₂ 0,3 +0,15/-0,2 mm

**Empfohlene Anschlussflächen
Recommended pad layout**



Reflowlötung / Reflow soldering

- G 0,5 mm
- Y 0,95 mm
- X 0,95 mm
- Z 2,4 mm

Wellenlötung / Wave soldering

- G 0,5 mm
- Y 1,2 mm
- X 1,1 mm
- Z 2,9 mm

Aufbau

Keramiksubstrat
Schmelzleiter gedruckt
Lötwärmebeständigkeit:
nach IEC 60068-2-58
260° C, 10 s (Lötbad)
260° C, 10 s (Reflow)
Vibration:
IEC 60068-2-6
Isolationswiderstand:
IEC 60127-4
Verpackung
1000 Stück gegurtet (GT-1K)
5000 Stück gegurtet (GT-5K)
20000 Stück gegurtet (GT-20K)

Construction

Ceramic substrate
Printed fuse-element
Resistance to soldering heat:
to IEC 60068-2-58
260° C, 10 s (Solder bath)
260° C, 10 s (Reflow)
Vibration:
IEC 60068-2-6
Insulation resistance:
IEC 60127-4
Packing
1000 pcs. on tape (GT-1K)
5000 pcs. on tape (GT-5K)
20000 pcs. on tape (GT-20K)

Construction

Céramique
Élément fusible imprimé
Résistance chaleur soudée:
à IEC 60068-2-58
260° C, 10 s (Bain de soudure)
260° C, 10 s (Ré écoulement)
Vibration:
IEC 60068-2-6
Résistance d'isolation:
IEC 60127-4
Emballage
1000 pcs. sur bande (GT-1K)
5000 pcs. sur bande (GT-5K)
20000 pcs. sur bande (GT-20K)

Schmelzzeit-Grenzwerte

Fusing time limits

Temps de fusion limité

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	1,25 x I _n		2 x I _n		2,75 x I _n		4 x I _n		10 x I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
500 mA – 2 A	1 h	5 s	-	-	-	-	-	-	-	1 ms

UL 248-14 IEC 60127-4	0603 (1,55 x 0,85 mm)	32 V	sup'flink (ver'quik- acting) (très rapide)	Type 152000
----------------------------------	---------------------------------	-------------	---	------------------------------

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	Bem.-Ausschaltverm. Breaking capacity Pouvoir de coupure	Spannungsfall Voltage drop Chute de tension	Kaltwiderstand Cold resistance Resistance à froid	Schmelzintegral I ² t's value Intégral de fusion @ 10 x I _n	Kennzeichg. Marking Marquage	Approbat. Approvals Homolog.
mA/A		mV	mΩ	A ² s		UL VDE
500 mA		415	640	0.0009	F	x x
630 mA		334	400	0.0014	CT	x
750 mA		278	280	0.002	G	x
800 mA		243	230	0.0023	CV	x
1 A		220	170	0.0028	H	x x
1,25 A		182	110	0.0039	J	x
1,5 A		169	85	0.0059	K	x
1,6 A		160	76	0.0065	EF	x x
1,75 A	50 A @ DC 32 V	167	72	0.0077	L	x
2 A		170	65	0.0101	N	x x
2,5 A		150	45	0.0157	O	x
3 A		140	32	0.0227	P	x
3,15 A		135	29	0.025	EL	x x
3,5 A		135	26	0.0308	R	x
4 A		142	23	0.0403	S	x



UL:
UL recog.